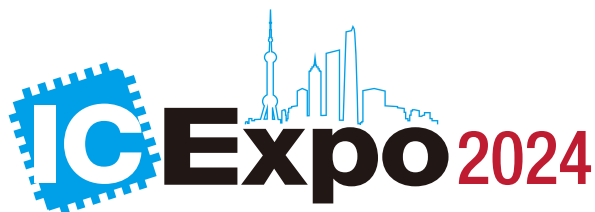


“芯”设计 “芯”风向



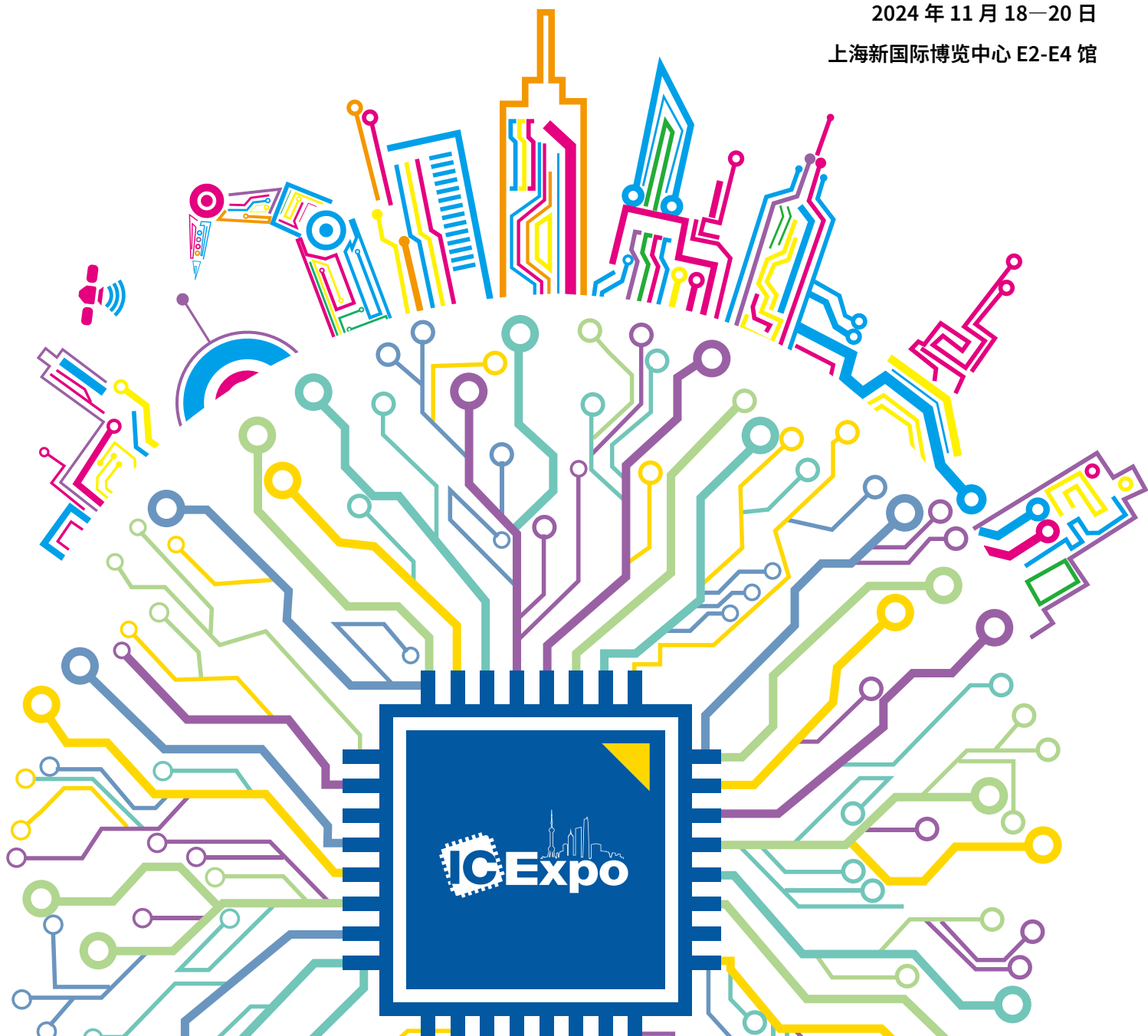
2024中国国际集成电路产业与应用博览会

2024 China International IC Industry and Application Expo (IC Expo)

同期

第 104 届中国电子展
2024 中国国际第二十八届小电机技术、磁性材料技术展览会

2024 年 11 月 18—20 日
上海新国际博览中心 E2-E4 馆



中国集成电路将顺势而为， 逆势崛起



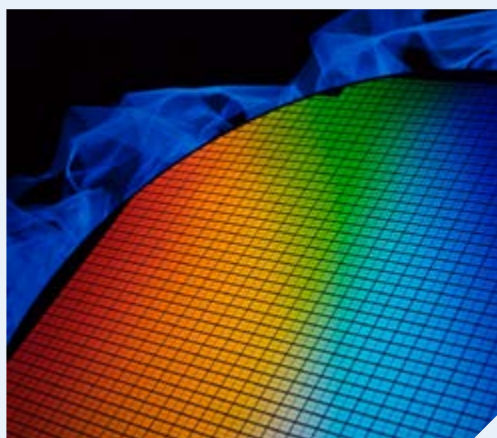
“十四五”期间，我国半导体产业将有更全面的发展，并将加快高端芯片设计等领域关键核心技术的突破和应用。随着中国对 5G、AI、IoT 和云计算、大数据等技术的大量投资，以 5G 网络、工业互 / 物联网等为代表的“新基建”将带动半导体产业的高速增长。据预测，到 2030 年我国的半导体市场供应将达到 5385 亿美元，依然为全球最大，69% 的消费量将来自中国本土公司，需求主要来自数据中心、消费电子、汽车、医疗等应用领域。

上海，增强集成电路产业自主创新能力， 努力打造完备产业生态

上海在“十四五”期间要增强集成电路产业自主创新能力，努力打造完备产业生态，加强前瞻性、颠覆性技术研发布局，构建上海集成电路研发中心等为主要支撑的创新平台体系，围绕国家重大生产力布局，推动先进工艺、特色工艺产线等重大项目加快建设尽早达产，加快高端芯片设计、关键器件、核心装备材料、EDA 设计工具等产业链关键环节攻关突破，加强长三角产业链协作，逐步形成综合性集成电路产业集群，带动全国集成电路产业加快发展。



中国国际集成电路产业与应用博览会 呼之欲出



随着数字化转型和 5G 的商用化推广，智能终端、自动驾驶、人工智能、物联网的发展将越来越快，芯片的类型、规格也会越来越多。对集成电路设计企业而言，不仅要面对产品迭代加速、客户诉求演进的挑战，由于全球疫情及国际形势造成的影响，还要应对需求波动巨大与制造周期进一步拉长的“供应链”危机。

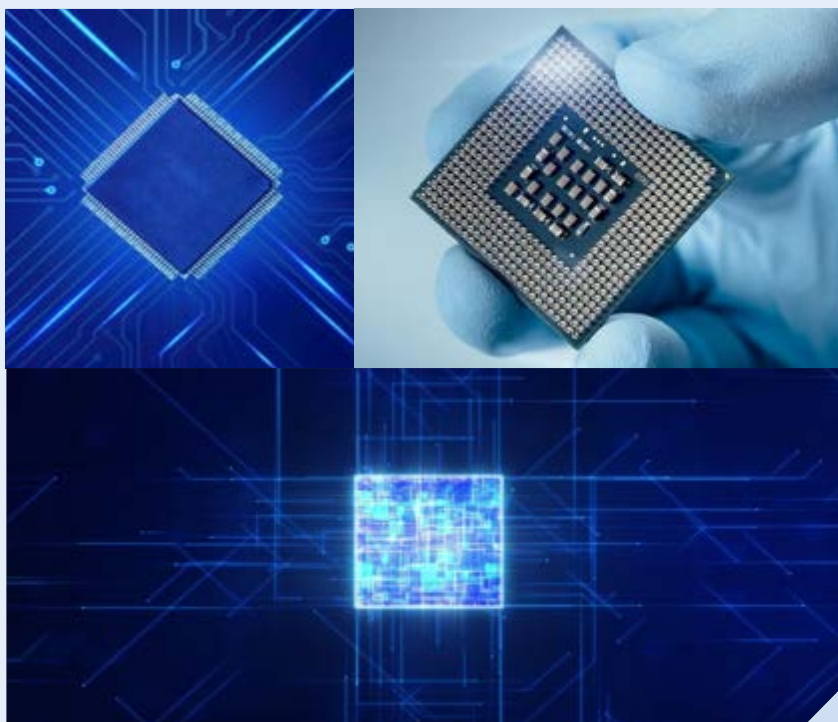


中央经济工作会议明确指出，要增强产业链供应链自主可控能力，国家集成电路发展相关规划也要求全面提升和改变产业生态。从国家到企业，尤其是崛起当中的中国集成电路设计行业，都要积极应对，化危为机。为此，2024 中国国际集成电路产业与应用博览会将以设计和应用为重心，从供需配套入手，集合供应链和分销采购多功能，为企业创造交流的平台，助力半导体行业发展。

1

集成电路技术与产品

“十四五”规划强调要加快高端芯片等领域关键核心技术突破和应用，以及集成电路设计工具、集成电路先进工艺和 IGBT、MEMS、MCU、CPU、嵌入式、存储等特色工艺突破，和先进存储技术升级，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展等，都为集成电路设计创新与产品出新创造了广阔的空间。



2

集成电路赋能热点应用与方案：

物联网、汽车电子、特种电子、电机驱动、工业控制

5G、物联网、AIoT、大数据、自动驾驶技术等新兴技术催生了新产业、新业态、新模式，推动全球制造业的产业格局显著调整。特种电子元器件是国防科技工业的重要基础，是国家先进制造业创新体系的重要力量，直接对我国综合国力及尖端科技技术的发展起到重要作用。中国制造业发展进入新时代，由高速发展转到高质量发展，核心技术自主创新是我国高质量发展的重要内容。在新时代发展需求和国内、国际形势下，将给集成电路设计企业带来大规模的市场需求。

物联网

汽车
电子特种
电子工业
电子

展馆分布图



历届知名厂商



E2 馆：IC 设计、IC 制造、IC 封装测试

IC 设计：移动处理器、射频 / 基带芯片、电源管理芯片、存储芯片、CPU、存储器、MCU、DSP、电机驱动芯片、模拟 IC、FPGA、AD/DA、纹识别芯片、第三代半导体、IC 工具与服务、半导体分立器件、半导体光电器件、功率器件、功率模块等；

IC 设备和材料：晶圆制造设备（光刻机、CVD 设备、刻蚀机、PVD 设备）测试设备、封装设备、半导体器件设备、材料设备、芯片设备、封装制造设备和核心部件、集成电路设备、太阳能电池芯片设备、LED 设备、第三代半导体设备、材料等；

IC 制造：晶圆制造工艺（热处理、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积、化学机械研磨和清洗）

IC 封装测试：BGA、WLP、SiP 等先进封装技术、MEMS 和传感器封装。

E3 馆：集成电路赋能热点应用与方案

汽车电子、特种电子、5G、AI、IoT 场景应用、物联网、电机驱动、工业控制等

E4 馆：2024 中国国际第二十八届小电机技术、磁性材料技术展览会

各类电机、电机控制系统及装置类、各类磁性材料、特种机器人等



论坛活动

技术论坛：

- 电机驱动芯片技术研讨会
- MCU 生态大会
- 中国半导体设备与核心部件新进展论坛
- 汽车电子产业链主题论坛
- 智能汽车芯片前瞻技术论坛
- AI 硬件加速器大会
- 特种电子集成电路与元器件自主创新发展论坛
- 5GAIoT 产业峰会
- 传感器技术研讨会
- 微特电机暨特种机器人创新发展论坛

供需对接会：

特种电子集成电路与元器件供需对接会

新产品新技术发布：

新产品新技术发布会：IC 专场

创新评选：

《本土 MCU 新锐十强》排行榜发布

行业聚会：

2024 年电子工程师嘉年华

上届相关话题和人物回顾

人物	话题
陈骋，复旦大学网络空间国际治理研究基地特邀研究员	细品“芯片法案”
王鹏，上海复旦微电子集团股份有限公司	“芯”起点，新未来，复旦微电 MCU 的国产化之路
潘钰霏，崇伯半导体猎头创始人	芯片人的 2023
林奇锋，广州菲克斯达半导体有限公司 总经理	AI 视觉检测技术在半导体制程的运用
杨晴，陕西维视智造科技股份有限公司 解决方案经理	AI 工业视觉在半导体行业的应用
何小庆，知名的嵌入式系统专家，嵌入式系统联谊会秘书长	嵌入式技术发展的三个趋势
雷江峰，澎湃微电子市场总监	品质奠定基石，创新打造未来
李艳，RT-Thread 全球社区运营经理	RTOS 引领嵌入式产业“智”造升级！
丘宁冰，创芯工坊联合创始人及市场总监	创“芯”固件加密与安全交付新模式
王娜，北京北方华创微电子装备有限公司战略发展副总裁	国产装备助力算力时代先进封装产业腾飞
聂佳相，江苏微纳纳米科技股份有限公司资深销售总监	原子层沉积技术在半导体中的应用
叶国光，无锡邑文电子科技有限公司副总经理	第三代半导体 8 英寸薄膜刻蚀设备
沈文杰，浙江晶盛机电股份有限公司研发副总监	半导体关键设备国产化进展
周许超，上海微电子装备（集团）股份有限公司光学检测平台副总经理	基于先进光刻技术的精密半导体量检测设备
李树瑜，天津吉兆源科技有限公司总经理	多种双频匹配器在半导体设备上的应用
周蕾，上海华湘计算机通讯工程有限公司总经理	光伏半导体射频电源研发生产老化用设备
粟放，厦门宇电自动化科技有限公司副总经理	高精度智能温控器赋能半导体制造
叶乐志，北京工业大学副教授	半导体封装测试设备国产化进展
李晋湘，华大半导体有限公司总工程师	国产设备应用新进展
卢万成，上海市汽车工程学会汽车电子电器专委会副主任	车规级芯片供应链现状与优化策略
陈大为，中国电子技术标准化研究院副总工程师	车规芯片可靠性问题现状
金星，上海汽车芯片工程中心首席技术官	车规芯片国产化的策略与尝试
曹书峰，上汽·智己汽车域控制器专家	面向智能化电子架构的超算芯片需求
张弘毅，上海磐易科技有限公司 CEO	软硬协同挖掘芯片潜力
范添彬，芯来智融半导体科技（上海）有限公司车规功能安全经理	通过车规 ISO 26262 的 RISC-V 处理器 IP
赵林祥，合肥杰发科技有限公司高级产品经理	驾舱融合趋势下的汽车 SoC 芯片布局
王李冬子，深圳卓时科技有限公司 CTO	量产和降本，面向全固态激光雷达的国产面阵 SPAD 芯片全解析
何积生，爱亚系统开发（上海）有限公司（IAR）高级客户经理	IAR 全面助力车规芯片安全应用开发
...	...

服务内容	钻石赞助 150, 000 元	黄金赞助 70,000 元	白金赞助 50000 元	白银赞助 30000 元
战略合作名义（各类资料推广）	√			
主题演讲 20-30 分钟	√	√	√	√
听众名单（150+）	√	√	√	
特装展位 100 平方米	√			
特装展位 36 平方米		√		
标准展位 18 平方米			√	
标准展位 9 平方米				√
会刊广告整版	√	√	√	
官方推广（微信、微博、官网）	√	√	√	√
媒体专访	√	√	√	
现场宣传展示及资料入袋	√	√	√	√

展位价格	标准展位（3m × 3m）	光地展位（36m ² 起租）
	15000 元 / 间	1500 元 / 平米

* 标准展位双开口加收 10%

Buyers



行业买家

5G、AI、IoT、汽车电子、特种电子、电机、
工业互联网等行业观众应邀到会

地域组织

三省一市（上海、江苏、浙江、安徽）
组团买家主要来自于当地大型制造企业、电子学协会会员单位、当地高新科技园区企业和各地分销商

组团观众

预计约 **50+** 个参观团，

5000+ 位采购到场

买家采购专场活动

现场组织松下、日立等采购专场活动与重点
参展商会面

产业活动

通过多场产业活动，邀请行业采购技术参会
的同时，也制造企业参会，加强供应链自主
可控能力

提升参展效果、 助力企业品牌塑造

买家配对：

通过精准定位采购商的需求和展商的产品，为参展企业带来更加优质的采购商洽谈机会

VIP 买家团邀请：

组委会将主动邀请成都及周边地区的大型企业以及园区企业的中高层技术采购工程师到展会现场采购、参观

展商自邀请客户之礼遇：

对于您推荐的重点目标观众，我们将特别为他们准备免费周到的接待安排

专业技术演讲：

通过权威论坛发布或聆听行业导向、市场趋势、技术前沿等热点话题

重点传媒专访：

我们将邀请行业内最权威的一些媒体到现场，您可以向我们预约行业内VIP 媒体对企业新品、技术和业内重要人物的专访

展会快讯专访：

展会期间我们每天都将推出展会快讯，面向到场所有的观众、展商免费派发，受众面广

广告机会：

官方网站和电子通讯中的 banner 广告等发布机会

新品推广：

官网、专业媒体、微信等渠道推广参展商的新品

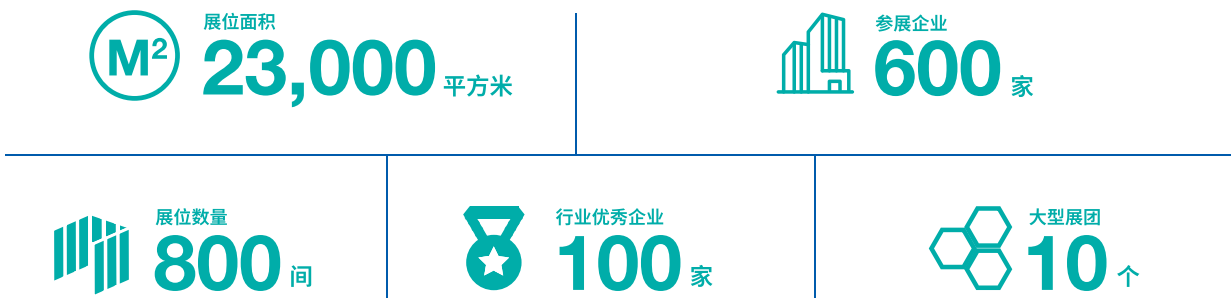
微信推广：

官方微信数万级的粉丝将在开展前接到新品咨询

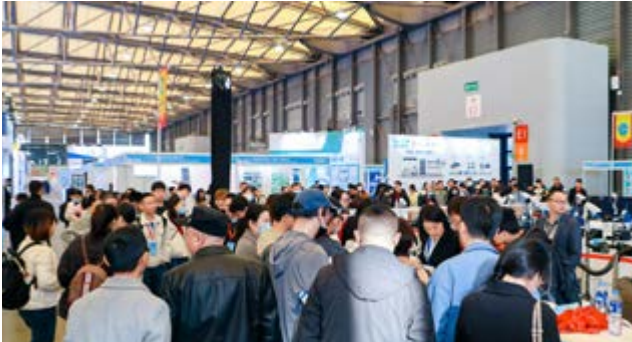
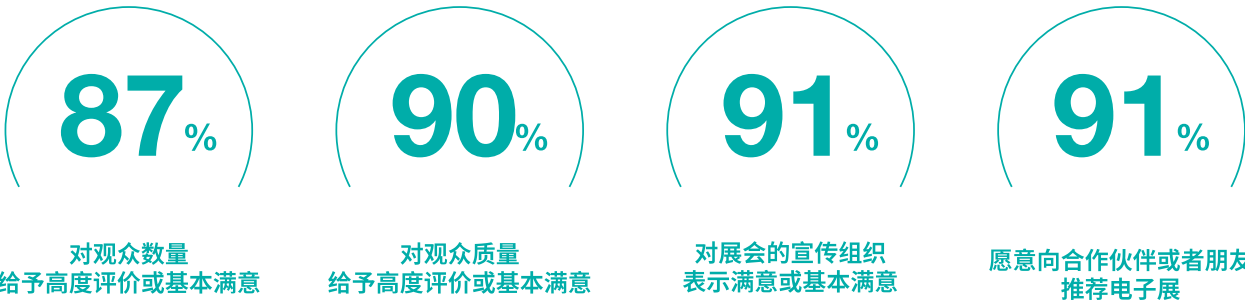


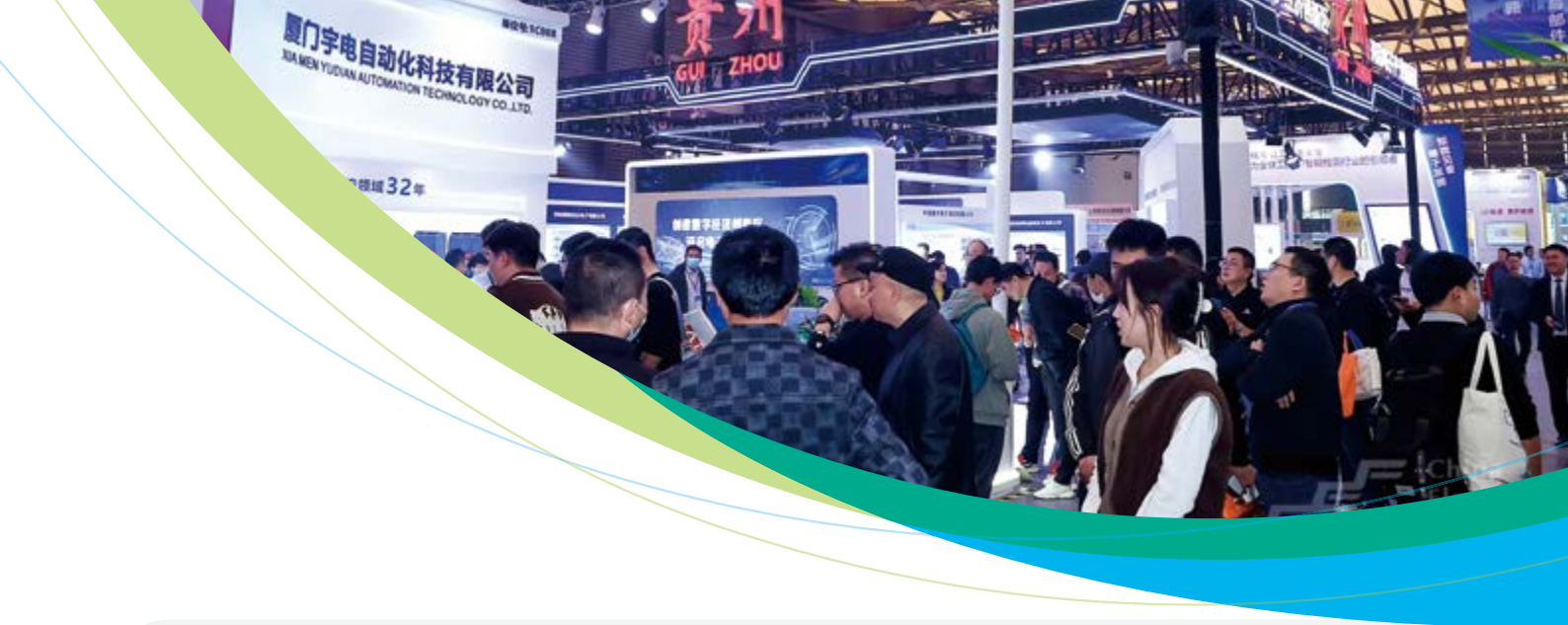
展商

展商分析



展商满意度分析





展商好评

紫光国微旗下国芯晶源作为晶振行业的佼佼者，8大产品全系列晶振产品悉数展出，应用领域涵盖网络通信、车用电子、工业控制、智慧物联、医疗器械、新能源、消费电子等各行各业。现场与许多观展厂商、专家学者共同探讨晶振行业发展的前沿趋势和广阔前景，参展体验非常好。

——国芯晶源



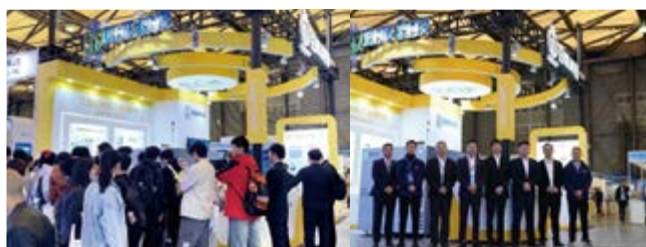
作为国内高端智能温控器的领军者，亮相中国电子展半导体核心部件展区。此次展会现场宇电发布了重磅新品——AI-9高精度温控器、AI-8848高精度多回路温控器，以及应用于工业互联网的多款产品，众多对宇电核心产品产生浓厚兴趣的顾客前来热情交流，现场人气爆满、场内互动踊跃。

——厦门宇电自动化



中国电子展是亚洲地区知名的专业电子信息产业展览会，此次展会吸引了众多行业专家与技术人才齐聚一堂，日联科技此次参展第102届中国电子展，现场收获颇丰。未来，日联科技将继续引领行业走向高速化、自动化、智能化工业检测新时代。

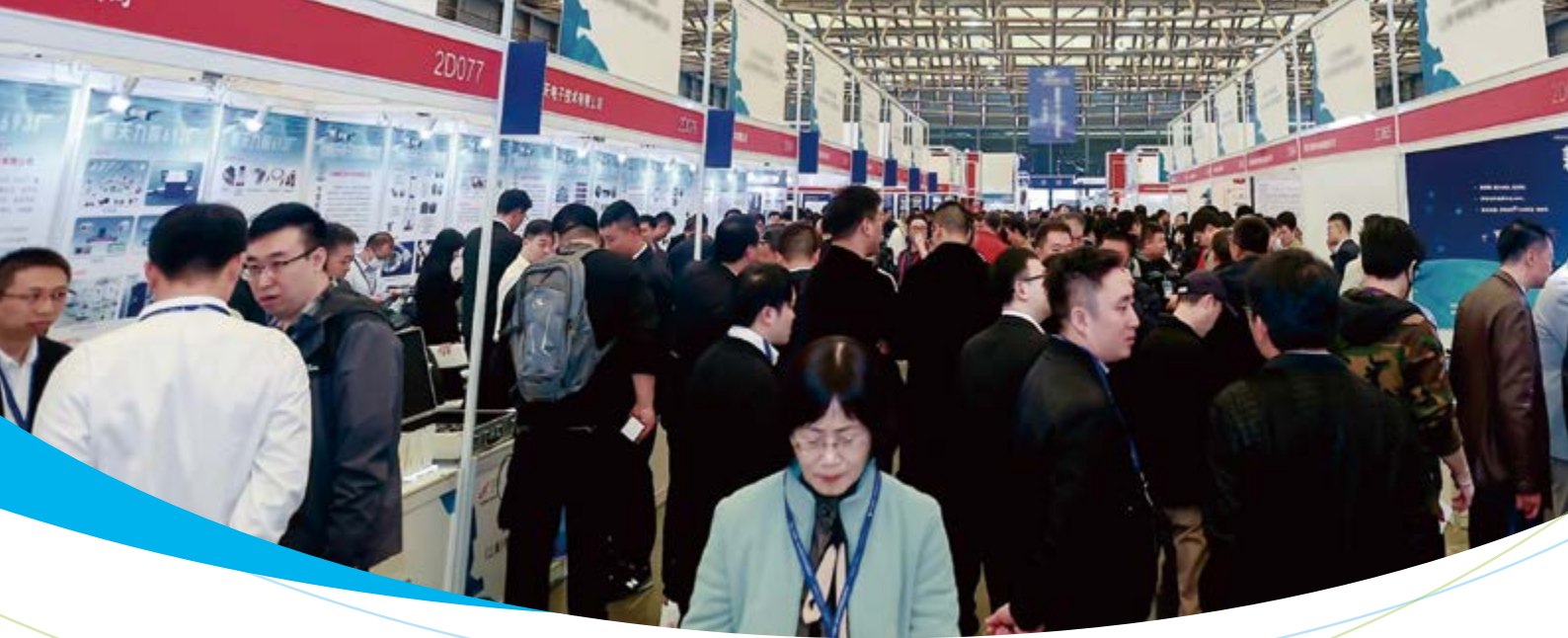
——日联科技



参展期间我公司展台现场，吸引了众多学界、业界的专家观众驻足参观、交流指导。参观客户络绎不绝，人潮涌动，盛况空前。客户对我公司的产品、技术及业务布局也表示高度认可，同时共同探讨行业趋势，展望未来发展。

——井芯微电子





观众

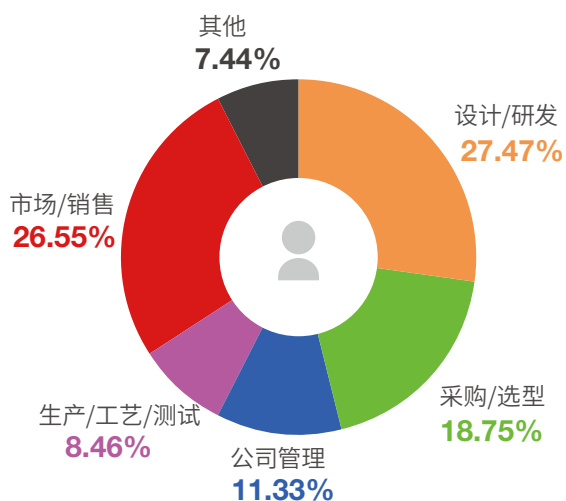
观众人数

24,698 人

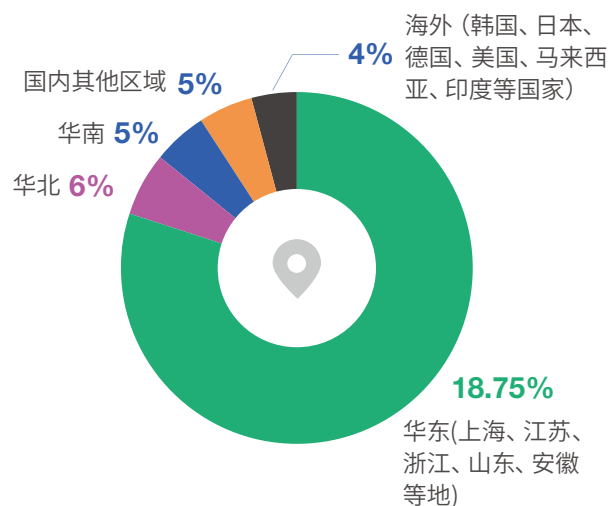
参观次数

34,709 次

观众职位分析



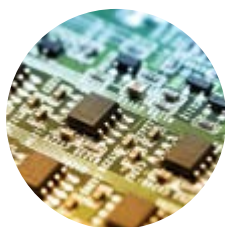
观众地域分析



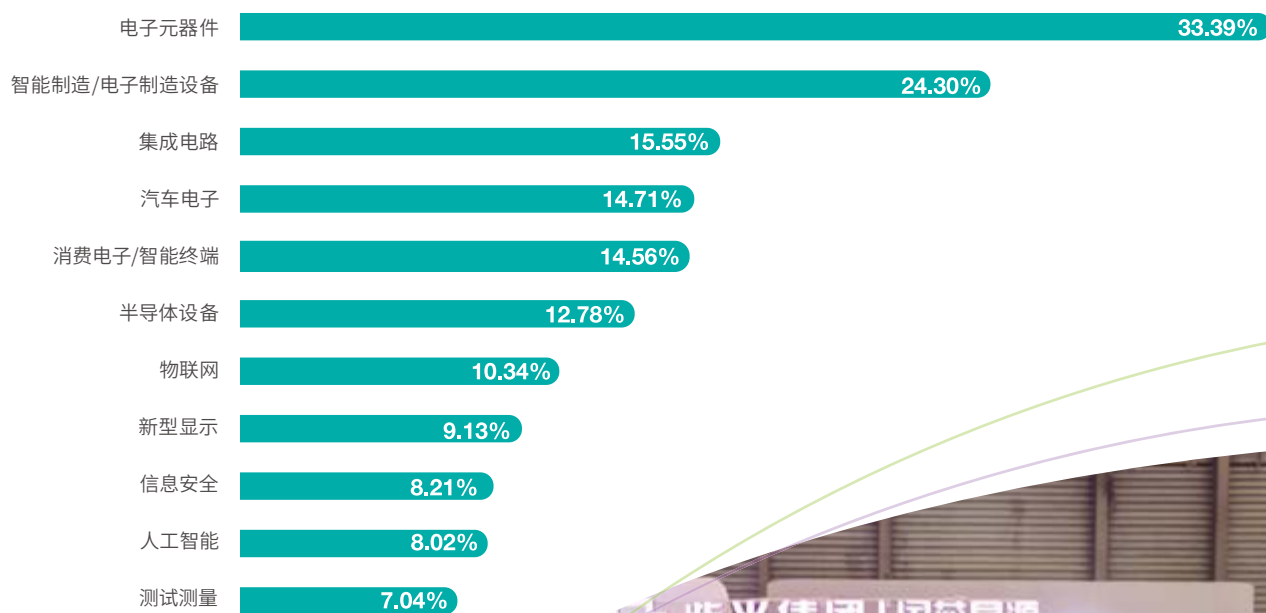
2023中国国际集成电路产业与应用博览会

2023 China International IC Industry and Application Expo (IC Expo)

展会
回顾



观众关注的产品和技术领域



参观团

大型参观团

50家

需方代表

5,000名

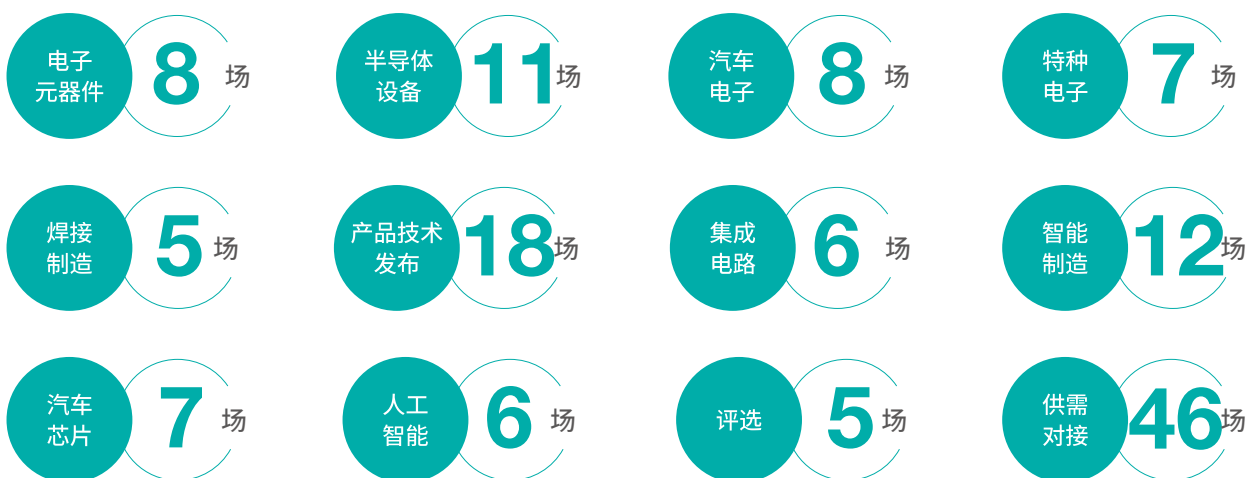
对接活动

46场

本届展会成功邀约包括中达电子、杭州航天电子、苏州松下半导体、东芝、上海诺雅克、上海芯哲微电子、上海电控研究所、蔚来汽车等近50家团体采购商，他们手持千万大单来到现场，与参展商面对面沟通。本届展会不仅汇聚多家大型制造型企业，还有政府组团、行业协会、重点企业、大学校园组团参观，还吸引了国内重要园区前来参加，如上海浦东软件园、上海张江科技园区、上海漕河泾科技园区、吴江经济开发区、浙江省半导体行业协会、杭州数字经济协会等。同时，还邀请了十大军工集团物资采购部门代表近5000人参会，包括航天科技、航天科工、航空工业、中国船舶、兵器工业、中国电科、中国电子和中科院、中物院等参观展会。



论坛活动



市场推广



合作专业媒体宣传推广

70+ 多家



新闻稿件

100+ 篇



新闻链接

2,000+ 条



稿件曝光

500多万 次



主流媒体专题报道

10 版



报纸杂志刊登

400 版



媒体banner

200 多个



广告曝光

200多万 次



视频发布

100 多条



曝光

200多万 次

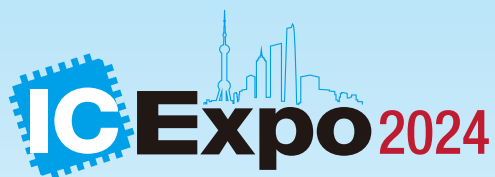


信息流广告曝光

800多万 次

专业媒体达成深度合作，涉及元器件、半导体、智能制造、电源电池、智能硬件、财经等多个领域。代表性媒体包括电子产品世界、芯片揭秘、半导体芯闻、21ic中国电子网、电子发烧友、电子工程世界、Techsugar、电子技术应用、与非网、国际电子商情、芯师爷、中国测控网、高工机器人、电源网、新电子、财经头条等。

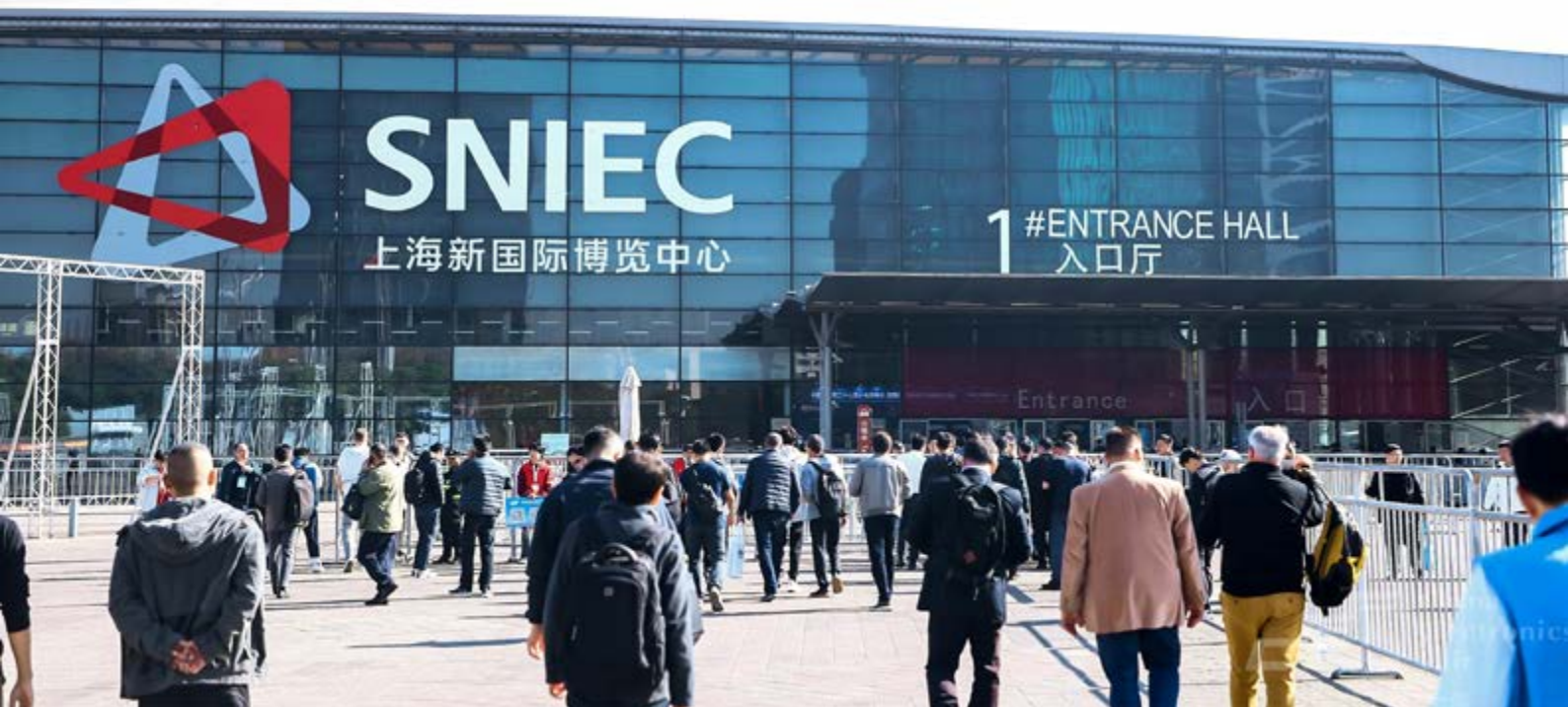
开展期间，组委会邀请电子发烧友、与非网、智能制造网等多家优秀行业媒体来到展会现场观展、宣传，并通过新闻推送、广告、邮件、社交网络、新媒体等方式进行多维度、多渠道曝光。

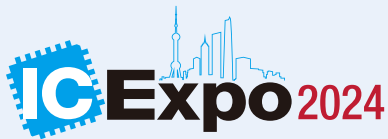


2024中国国际集成电路产业与应用博览会
2024 China International IC Industry and Application Expo (IC Expo)

2024 年 11 月 18—20 日
上海新国际博览中心 E2-E4 馆

期待您的光临





指导单位：

中华人民共和国工业和信息化部
中华人民共和国商务部

主办单位：

中国电子器材有限公司
上海市集成电路行业协会

承办单位：

中电会展与信息传播有限公司

协办单位：

中国 RISC-V 产业联盟
浙江省半导体行业协会
陕西省半导体行业协会
成都市集成电路行业协会
绍兴市集成电路行业协会
苏州市集成电路行业协会
中国电子仪器行业协会
中国电子专用设备工业协会
电子制造产业联盟
求是缘半导体产业联盟
浙江省照明电器协会
上海市汽车工程学会
江苏省汽车工程学会
浙江省汽车工程学会
安徽省汽车工程学会

合作媒体：

中国电子商情	单片机与嵌入式系统
电子创新网	电子发烧友
电子产品世界	电子工程世界
芯榜	集邦咨询
半导体圈	集微网
半导体门户	猎芯网
半导体封测	摩尔精英
电子技术应用	我爱方案网
21ic 电子网	芯片揭秘
IC 交易网	芯师爷
TechSugar	芯思想
半导体世界	与非网
半导体网城	中电港
半导体芯科技	今日半导体
存储在线	

负责人：侯先生 手机（微信）：13810788214

电话：010-63937966 QQ：83226505

E-mail：hxx@cead.com.cn

地址：北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦A座28层